

令和6年度 京都実装技術研究会 第4回例会

京都実装技術研究会は、昭和62年に発足し、電子機器の生産に深く関わる基盤技術である接合・実装技術を中心に、生産現場の高度化のために必要な課題や各社が抱えている共通の問題をテーマにした活動を行い、参加企業の技術水準向上に努めています。

この度、本年度第4回例会として、リフロー炉の実演講習を実施します。皆様のご参加をお待ちしております。

◇ 開催日時 令和6年11月7日(木) 13:00 ~ 16:30
(応募多数の場合は、予備日11月8日にも開催します)

◇ 開催方式 会場参加(実演講習のため会場参加のみとなります)

◇ 会 場 京都府産業支援センター 1階 企業連携技術開発室
(京都市下京区中堂寺南町134 京都リサーチパーク東地区内)

◇ 内 容

「リフロー炉 実地講習」

実装技研 河合 一男 様 アントム株式会社 浅野 光一 様

会場に設置したリフロー炉(UNI-6116α;アントム社)を使用して講習を行います。

プリント基板へのはんだ印刷から部品取り付け、リフローまでを実施し、温度プロファイルの考え方等について解説します。

1. 温度プロファイルの作成

*上下ヒーターの使い分け、*濡れ広がり性、*プリートの長い(JEITA)温度プロファイル、*プリヒートの短い温度プロファイル、*下部ヒーターの活用

2. ディスクリット部品のリフロー

*はんだ供給方法

3. 耐熱性の低い部品(フロー部品)のリフロー化

4. その他

※講習後は懇親会も開催します(会費は研究会より一部補助あり)

◇ 定 員 10名程度

◇ 参 加 費 会員：無料 非会員：10,000円
(研究会入会希望の方は事務局までお問合せください。年会費20,000円/社)

◇ 申込締切 令和6年11月4日(月)まで
※懇親会にご参加される場合は10月31日(木)までにお申し込みください。

◇ 問合せ先 京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気通信係
(京都実装技術研究会事務局)
TEL 075-315-8634 FAX 075-315-9497
E-mail jisso@kptc.jp

令和6年度 京都実装技術研究会 第4回例会申込書

会社名				
所在地				
連絡担当者	所属・役職			
	氏名			
	E-mail			
	電話番号			
	参加方法	☐ 会場 ☐ 連絡のみ担当（本人は不参加） ※参加方式は会場参加のみ		
	懇親会	☐ 参加 ☐ 不参加		
上記以外の参加者	所属・役職	氏名	E-mail ※個別連絡も希望する場合は記入	懇親会
				☐ 参加 ☐ 不参加
				☐ 参加 ☐ 不参加
				☐ 参加 ☐ 不参加
				☐ 参加 ☐ 不参加
備考				

※参加申し込み締め切り 11/4（月）まで

懇親会へのご参加を希望される場合は 10/31（木）までにお申し込みください。

（期限後にご連絡いただいた場合は、会場手配の都合上、参加をお断りする場合があります）

※申込書に御記入いただいた個人情報は、本研究会受講者名簿として活用します。

受講に当たっての注意点

- ・会場には消毒液を設置します。ご来所の際は手洗いか手指消毒をお願いします。
- ・発熱等の症状がある方はご来場をお控えください。